VISUALIZE THE FUTURE



2021年3月期 第2四半期

決算説明会

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 2020年11月13日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。



2021年3月期 第2四半期 決算説明

今期のテーマと事業の進捗状況

2021年3月期 通期業績予想と成長イメージ

注力領域と新規取り組み



2021年3月期 第2四半期 決算説明

2 今期のテーマと事業の進捗状況

- 3 2021年3月期 通期業績予想と成長イメージ
- 4 注力領域と新規取り組み

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響



短期的にはマイナス影響も、中期的には市場構造変化もありプラス影響

	影響要因	当社業績へのインパクト	
事業/市場		短期 FY2020	中期 FY2021-
業務推進体制	3月初旬より全役職員WFH (Work From Home) 可に罹患者ゼロを継続現在の出勤率5割程度) 可に 一 土	
	• 顧客アプローチには若干の影響 (Web Approach強化)		
アミューズメント 市場	ホールの稼働率は回復安定(8割程度)旧規則遊技機の撤去と新規則遊技機への入れ替えは2021年 12月に向けて計画的に行われていく見込		
	足下の新台の検定通過率が低いホールの遊技機購入意欲が弱含み遊技機メーカーの製品・生産計画に影響		+
AIソリューション 事業	ロボティクスは、感染対策に伴う需要拡大によりPoC (Proof of Concept) 受注含め引き合い増加傾向	_	+
	• 一部顧客の開発投資に一時的な抑制傾向		•

2021年3月期 第2四半期決算八イライト - 損益計算書



ベトナム子会社の事業開始に伴い、連結決算体制に移行(前年同期との単純比較できず) (但し、ベトナム子会社の売上高は現段階では本社へのデザインサービス収入のみで、外部売上なし)

(単位:百万円)	2020年3月期 第2四半期 (個別)	2021年3月期 第2四半期 (連結)
売上高	293	533
営業利益	△207	△191
経常利益	△231	△155
四半期純利益	△231	△156

- IPライセンス事業は既存ランニングロイヤリティの減、プロフェッショナルサービス事業は一部顧客 の開発投資減の影響により、前年同期売上高を下回ったが、グラフィックプロセッサー「RS1」の 量産出荷はCOVID-19流行の逆風の中、前年を上回った
- 前年同期に営業外費用に計上した新株発行費が剥落するとともに、営業外収益にNEDOからの助成金 収入を計上したことにより、営業外収支が改善

2021年3月期 第2四半期決算ハイライト - 事業別売上高



IPコアライセンス事業

売上高 61百万円

前年同期個別(参考) 82百万円

- ●デジカメ中心にデジタル機器向けの既存ランニングロイヤリティが減少
- ●一部顧客の開発投資/開発プロジェクトの抑制・延伸の影響あり
- ●ロボティクス向けの新規ライセンスを獲得。AIによる安全運転支援に係るランニングロイヤリティの計上開始

LSI製品事業

売上高 383百万円

前年同期個別(参考)111百万円

●RS1の量産向けおよびAI FPGAモジュール「ZIA™ C3」の売上を計上

プロフェッショナルサービス事業

売上高 87百万円

前年同期個別(参考) 99百万円

- NEDO AIエッジコンテストの受託収入および安全運転支援、ロボティックビークル向け等のAI関連受託 開発サービスの売上を計上
- ●一部顧客の開発投資/開発プロジェクトの抑制・延伸の影響あり

2021年3月期 第2四半期決算ハイライト - 貸借対照表



自己資本比率は92.6%と高水準を維持

第2四半期の役員/従業員向けRS発行により、資本金、資本剰余金がそれぞれ34百万円増加

	(単位:百万円)	2020年 3月末 (個別)	2020年 9月末 (連結)	主な内訳
	流動資産	3,077	2,951	現預金 2,050, 有価証券 443 売掛金 295
	固定資産	763	778	投資有価証券 500 ソフトウエア 131
資	産合計	3,841	3,730	
	流動負債	279	255	買掛金 208
	固定負債	18	18	資産除去債務 17
負	債合計	298	274	
純資産合計		3,543	3,455	資本金 1,838, 資本剰余金 1,858 利益剰余金 △232
負債・純資産合計		3,841	3,730	



1 2021年3月期 第2四半期 決算説明

今期のテーマと事業の進捗状況

3 2021年3月期 通期業績予想と成長イメージ

4 注力領域と新規取り組み

2021年3月期の重点テーマと進捗



● Robotic Vehicle分野への取り組み

- 注力領域を市場拡大が期待されるRoboticsに拡張し、AI画像認識機能を協働ロボット等に実装
- ヤマハ発動機様との協業は、低速車両領域における省力化、自動化(自動運転/自律運転)技術等の開発を引き続き推進
- 高精度SLAM^{※1}の開発

● Safety/DMS^{※2}分野への取り組み

- Amazon Web Servicesを活用したSaaS^{※3}型クラウドサービス(ZIA™ Cloud SAFE)開発により、業界初のエッジ側リアルタイム処理とクラウド処理のワンストップソリューションを提供
- ランニングロイヤリティ、サブスクリプションライセンスによるリカーリングビジネス実現

● アミューズメント分野の強化

- RS1の新規顧客開拓の取り組みを強化
- 品質管理体制の強化

- **%1** Simultaneous Localization and Mapping
- ***2 Driver Monitoring System**
- **%3** Software as a Service

AI製品のポートフォリオ拡充、拡販

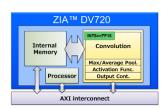


ZIATM AIプロセッサーIP、モジュール、ソフトウエア製品の拡充と採用拡大を継続

IPコア製品

Z : A™ DV720/DV740

ディープラーニング を使ったコンパクト で高性能なAI推論 プロセッサーIP



用途

- AI内蔵カメラSoC
- 自動運転SoC

アップ デート

- ZIA™ DV740 発表
- ZIA™ ISP 発表

取り 組み

- 性能向上
- ラインアップ強化

成果

ロボティクス、民生機器、 産業機器に採用

モジュール製品

ZIA C3

7IA™ DV720をFPGA に搭載したフレキシブ ルで低消費電力なAI 推論処理モジュール



用途

- 産業機器
- ロボティックス
- 医療機器

デート

• 新規量産開始

取り 組み

成果

- 車両AI評価キット共同開発
- 業務用車両の周辺監視用に 採用

ソフトウエア製品・サービス

ZIA SAFE ZIA Cloud SAFE

Z¦A[™]Classifier Z¦A[™]Plate

- •AI、画像処理技術をベースに独自開発 した高度な画像認識エンジン
- ドメインに最適化したプロフェッショ ナルサービスの提供

- ドライバーモニター
- ヒヤリハット解析
- 医療診断

デート

• ZIA™ Cloud SAFE 発表

取り 組み

• 成長ドメイン向け最適化

成果

- ドライブレコーダー複数顧客 に採用
- リカーリングビジネス開始



1 2021年3月期 第2四半期 決算説明

2 今期のテーマと事業の進捗状況

- 2021年3月期 通期業績予想と成長イメージ
- 4 注力領域と新規取り組み

2021年3月期 通期業績予想



短期的にはCOVID-19のマイナス影響。中期的成長実現の取り組みを強化

(単位:百万円)	2020年3月期 (個別実績)	2021年3月期 第2四半期 (連結実績)	2021年3月期 (連結予想)
売上高	1,328	533	1,500
営業利益	82	△192	△ 150
経常利益	85	△155	△ 100
当期純利益	65	△156	△ 100

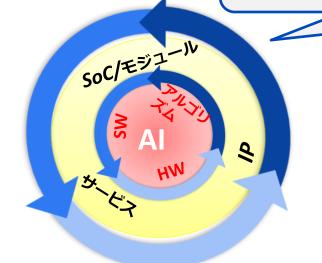
- 足下の新台の検定通過率が低いことやホールの遊技機購入意欲が弱含みであることが、遊技機メーカーの製品・生産計画に影響を与えていることから、LSI製品事業の伸びが想定を下回る
- AI関連の一部顧客の開発投資に抑制・延伸傾向があり、IPコアラインセンス事業およびプロフェッショナルサービス事業に影響(顧客の開発ロードマップに大きな変更はないため、この影響は時限的なものと想定)
- 2021年12月に向けた新規則機への入れ替え需要とシェア拡大により、アミューズメント市場における安定的な収益を獲得するとともに、注力領域かつ成長市場であるロボティクスや安全運転支援分野における新しい取り組みの加速による収益源多様化と収益拡大により、中期的な企業価値の拡大を図る

今後の成長イメージ



AI Computing Company「世界のDMP」へ飛躍

AIアルゴリズム、ソフトウエア、ハードウエアを一貫して開発



勝てる「アミューズメント市場」で

アミューズメントSoCトップシェアを目指す

成長するIoT・AI (人工知能) 分野へ拡大

ZIA AI プラットフォームの展開

- プロセッサーIP
- ソフトウエア
- モジュール
- パートナーとのエコシステム強化
- 海外展開

モビリティー/産業向けAIソリューション

- 自動運転
- ロボティクス、ロボティックビークル
- Safety / DMS

SoC/モジュールビジネス拡大

- 高付加価値モジュール
- ハイボリュームAI製品

現在地

フェーズ1

安定した経営基盤

マルチプラットフォーム

フェーズ2

フェーズ3



1 2021年3月期 第2四半期 決算説明

2 今期のテーマと事業の進捗状況

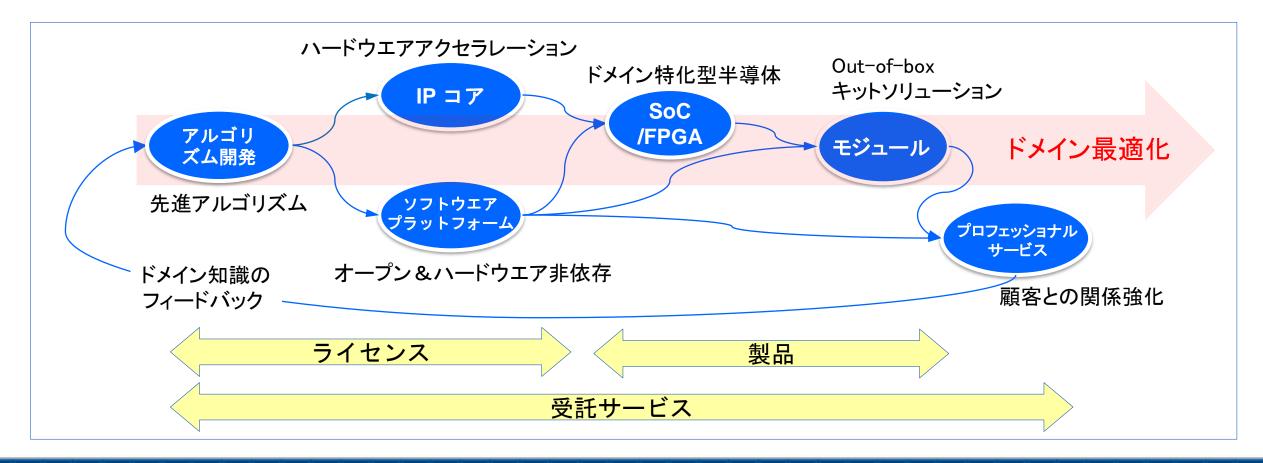
- 3 2021年3月期 通期業績予想と成長イメージ
- 注力領域と新規取り組み

DMP開発モデルの特徴



他社の追随を許さない、ドメイン最適化が可能な一貫開発モデル

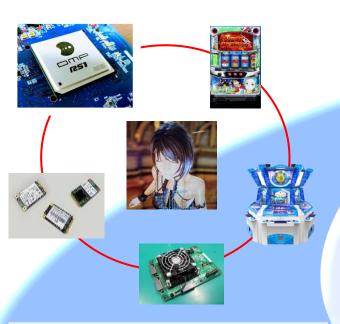
- ・アルゴリズム、ソフトウエア、ハードウエアを統合的に開発
- ・ライセンス、製品、プロフェッショナルサービスによる柔軟な価値の提供、収益化モデル



注力市場(Verticals)



アミューズメント



- 2D&3D統合SoC
- モジュール高付加価値ビジネス

Robotics



- ロボティックビークルの自動・自律運転技術
- ローコスト高精度SLAM
- 産業機器、ロボットアーム制御



セーフティ/DMS



- 安全運転支援ドメインノウハウの蓄積
- 最新アルゴリズムの集約
- エッジ&クラウドコンピューティング



Safety/DMS分野への取り組み



ZIA™ Cloud SAFE - SaaS型クラウドサービスの開始(2020年11月)

Z¦A™ Cloud SAFE AWSを活用した安全運転支援システム向けソフトウエア



ZIATM Cloud SAFEについて



● DMP初のSaaS型クラウドAIサービス

- 安全運転支援システム向け各種APIを提供
- エッジAI (ZIA SAFE)とシームレスに協調
- 継続的学習による精度の向上、機能向上
- Amazon Web Services ベース
- サブスクリプション課金モデル

● ZIATM SAFEと技術基盤共通化

- リアルタイム性、認識精度、負荷を考慮したシステム全体最適化
- スケーラビリティとアップグレーダビリティの確保





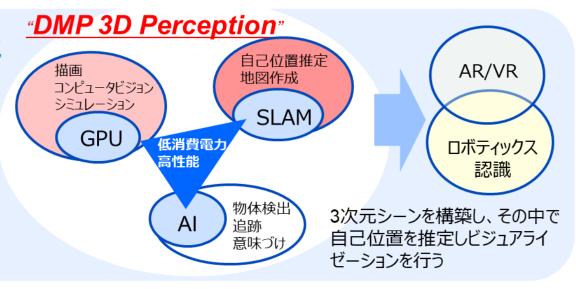
Robotics 分野への取り組み



DMPの固有技術をベースに新たな価値を創造

DMPのGPU、AI、SLAM技術を融合させ 次世代ロボティック・ビークルの目となる 高度な 3 D認識技術"DMP 3D Perception"を開発

SLAM: Simultaneous Localization and Mappingの略



- インテリジェントロボット(UGV, PPM, AGV他)の開発に向けた認識及び制御技術の開発
- 単眼カメラによる低コスト高精度SLAM技術の開発
- 自動運転標準オープンプラットフォームへのインテグレーション (Autoware)
- AI画像認識を使ったロボットアーム制御技術の開発
- 安全・セキュリティ分野への応用



協働ロボット周辺監視エッジAI画像認識ソフトウエア (リョーサン様・蔦屋家電様)



<お問い合わせ先>

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 経営企画部

TEL:03-6454-0450

URL: https://www.dmprof.com/jp/ir/

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもの であり、マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります。従いまし て、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや 不確実性がありますことをご了承ください。



Appendix

事業内容



事業	事業内容	主要顧客
IPコア ^{※1} ライセンス事業	精細画像の描画やディープラーニング(深層学習)*2などの人工知能(AI)*3に必要なハードウエアIP(論理設計データ等)やソフトウエアIP(主にハードウエアを制御するドライバーやコンテンツ制作を支援するツール類)の開発、ライセンス(使用許諾)供与a)ライセンス収入 顧客が家電製品等の開発を進める過程で、当社がIPコアライセンスのライセンスを与えたことによる対価b)ランニングロイヤリティ収入 顧客がIPコアを組み込んだ製品を販売する際に、製品出荷個数に応じて当社が顧客から収受する対価 c)保守サービス 保守契約に基づくIPコアの保守等	半導体メーカー 半導体が組み込まれた 最終製品メーカー
LSI製品事業	グラフィックス LSI*4(SoC*5)(主にアミューズメント機器向け)の開発・製造・販売(製造は委託)	半導体商社 半導体が組み込まれた
	AI LSI(FPGA ^{※6})(AIを使用する機器向け)の開発・製造・販売(製造は委託)	最終製品メーカー
プロフェッショナル サービス事業	当社の各種IPコアをインテグレーションしてSoCシステム全体を検討・最適化する設計サービス、自社製品の開発により培ったGPU*7/ビジョン/AI技術等をベースにしたアルゴリズム開発や最適化を行なうソフトウエア/ハードウエアサービス等さまざまなサービスを提供	半導体が組み込まれた 最終製品メーカー

- ※1:LSIを構成するための部分的な回路情報のうち、特に単一機能でまとめられたもの(例:グラフィックスIPコア)。IPはIntellectual Propertyの略称
- ※2:画像認識分野などで実用化が進む、人工知能を実現する機械学習の手法の一種。人間の脳を模したニューラルネットワークの仕組みを活用
- ※3:人間が行っている認知や判断を、コンピュータを使って行うためのソフトウエアやシステムのこと。文章、画像、会話、音などを理解し判断するコンピュータプログラムなど
- ※4:シリコンウエハ(半導体製品の製造に使用される導体と絶縁体の中間の性質を持つ物質)で形成される大規模集積回路。Large Scale Integrationの略称であり、「半導体」とも呼ばれる
- ※5:一つの半導体チップ上に必要とされる一連の機能(システム)を集積する集積回路(の設計手法)。System on a Chipの略称
- ※6:製造後に購入者や設計者が構成を設定・変更できる集積回路。Field Programmable Gate Arrayの略称
- ※7:コンピュータゲームに代表されるリアルタイム画像処理に特化した演算装置ないしプロセッサ。Graphics Processing Unitの略称。CPUよりも並列演算性能にすぐれた特性を生かし、その演算 資源を画像処理以外の目的に応用する技術(GPGPU: General-Purpose computing on GPU)がAI・ディープラーニング分野に活用されている

当社4月以降本日までの活動状況



各項目は当社ウェブサイトのPR/IRニュースにリンクしています

発表/開催日	内容
2020年4月1日	ベトナム子会社設立、事業開始
2020年5月11日	経済産業省、NEDO、SIGNATEとともに第3回AIエッジコンテストを開催
2020年5月14日	フランス Prophesee社とイベントベースビジョンセンサーを使った組込みマシンビジョンおよび人工知能(AI)アプリケーションの開発で協業
2020年6月8日	サイレックス・テクノロジー、PALTEKと車両AI評価キットを共同開発し、AIによる安全・遠隔・自動化ソリューション開発をサポート
2020年7月1日	経済産業省、NEDO、SIGNATEとともに第4回AIIッジコンテストを開催
2020年7月1日	フィンランド Basemark社と商用車用のスマートミラー開発で提携
2020年7月13日	ZIA™ ISP IPコア リリース
2020年7月13日	<u>ZIA™ DV740 IPコア リリース</u>
2020年7月15日	<u>ウェブサイトリニューアル</u>
2020年9月7日	<u>リョーサンの蔦屋家電 + への展示(協働ロボット)に画像認識AIソフトウエアを提供 (Blog)</u>
2020年10月28日	アムニモの産業用IoTデバイスにエッジAIプロセッサIPコア「ZIA™ DV720」が採用
2020年11月10日	Amazon Web Servicesを使ったSaaS型安全運転支援クラウドサービス「ZIA™ Cloud SAFE」を発表